|  |  |
| --- | --- |
| **國立臺北教育大學** | **產學合作意向書** |
| **○○○○○○公司** |
| （參考範本，請依實際需求修改） | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立書人： | 國立臺北教育大學 | （以下簡稱甲方） |
|  | ○○○○○公司 | （以下簡稱乙方） |

甲乙雙方為推動產學合作，奠定良好合作關係，以創造雙贏契機，雙方同意在平等互惠及誠信原則下，共同協商議訂合作事宜。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第一條** | **合作事項**  甲乙雙方得就合作方式與內容另行訂定合作合約，合約應明確規範合作細節以及相關經費。 | | |
| **第二條** | **保密協定** | | |
|  | 一、 | 甲乙雙方在未經他方事先書面同意前，不得將有關合作內容或是因洽談合作內容而知悉他方之技術或商業資訊洩漏予任何第三人，但該資訊在本意向書簽訂前已為公眾所知悉者不在此限。 | |
|  | 二、 | 未經揭露方事先書面同意，接受資訊之一方（接受方）不得洩露前項之機密資訊於第三人，或私自複製及運作於其它作業，該等保密義務於本意向書失效或終止後亦同。 | |
|  | 三、 | 揭露方向接受方揭露之「機密資訊」，其所有權、專利權、著作權、營業秘密或技術秘竅（KNOW-HOW）係揭露方或其原授權人所有，接受方不得據為己有而申請專利權、著作權等其他智慧財產權，或使第三人申請前述權利。 | |
|  | 四、 | 一方成員因可歸責於已之事由，違反本條款之規定致揭露方受有損害者，該方應負賠償責任。 | |
|  | 五、 | 甲乙雙方在未經他方事先書面同意前，不得使用他方之名稱、商標、或任何標識於任何產品、包裝、型錄、廣告、平面或電子媒體。 | |
|  | 六、 | 本條義務於本意向書屆期或終止後仍然有效，雙方如未簽訂正式合作契約書，則於本意向書屆期或終止後，接受方應依揭露方之要求銷毀或返還機密文件、物品、設備，不留存任何備份。 | |
| **第三條** | **無限制規定**  本意向書之簽訂未創設任何雙方合作關係，不代表任一方有義務簽署任何契約，或授權一方得代理他方，或限制任一方與任何第三人締結其他合作關係。 | | |
| **第四條** | **期限**  本意向書自簽訂日起生效，為期一年，期滿得經雙方協商後續約。 | | |
| **第五條** | **聯絡方式**  甲乙雙方同意以下列人員擔任有關合作範圍接洽之聯絡人： | | |
|  | 甲方聯絡人：○○○ | | Email：○○○○○○○○○○○○○○○ |
|  | 職稱：○○○○○○ | | 電話：○○○○○○○○○○ |
|  | 乙方聯絡人：○○○ | | Email：○○○○○○○○○○○○○○○ |
|  | 職稱：○○○○○○ | | 電話：○○○○○○○○○○ |
| **第六條** | **合約份數**  本意向書正本壹式二份，由甲乙雙方各執正本一份為憑。 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：  國立臺北教育大學　　 （簽章） | 乙方：  ○○○○○○公司　　 （簽章） |
|  |  |
| 代表人： ○○○ | 代表人：○○○ |
| 地址：台北市和平東路二段134號 | 地址：○○○○○○○○○○○○ |

**中 華 民 國** ○○ **年** ○○ **月** ○○ **日**